

公司代码：600703

公司简称：三安光电

三安光电股份有限公司
2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 未出席董事情况

副董事长林科闯先生因被留置无法出席董事会会议，亦未能授权委托其他董事代为出席会议。

4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，且实施了股份回购，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三安光电	600703	ST三安

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李雪炭
联系地址	福建省厦门市同安区民安大道 899 号
电话	0592-5937117
传真	0592-5937117
电子信箱	600703@sanan-e.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业包括 LED 行业及电力电子、射频前端、光技术等集成电路行业。根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类》（标准编号：GB/T4754-2017），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类下“半导体照明器件制造（3975）”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

1、LED 行业

根据 TrendForce 预测，受 LED 通用照明等市场需求低迷影响，2025 年全球 LED 照明市场产值将同比下滑 4.4%至 535.73 亿美元。展望 2026 年，一方面，伴随终端库存回归健康水位，LED 市场价格已企稳向好，根据 LEDinside 统计，2026 年初以来已有数十家 LED 相关企业宣布调涨产品价格，涨价全面覆盖上游芯片、中游封装及下游应用端；另一方面，LED 产业将从价格竞争进入价稳质升阶段，Mini/Micro LED、车载照明、商业航天、植物照明等高技术壁垒细分市场将成为企业利润增长的关键。

2025 年 Mini LED 在背光产品应用保持持续增长，直显领域市场也在起量。Mini LED 背光解决方案在电视、笔电、平板、显示器、车载显示等市场快速渗透，根据洛图科技数据，2025 年三大 Mini LED 应用终端——电视、显示器和笔记本电脑全球合计出货量约 1531 万台，同比增长 38.6%，其中电视为主要增量市场，2025 年全球出货量约 1,239 万台，同比增长 57.8%。同时，海信、TCL、三星、索尼等头部品牌厂商纷纷布局 RGB-Mini LED 架构，通过红、绿、蓝三色 LED 直发光，实现“光色同控”，显著提升亮度、色域与色彩纯净度，预计 2026 年全球 RGB-Mini LED 电视出货量将达 30 万至 40 万台。Mini LED 直显应用场景不断拓宽，包括 XR 虚拟影棚专用屏、影院屏和 LED 一体机（用于智慧教育、会议、医疗、指挥中心、展览展示、演播室等场所）等，渗透率随之走高。据洛图科技预计，2028 年 Mini LED 直显全球市场规模将达 33 亿美元，2024-2028 年的年复合增长率约为 40%，市场未来发展空间广阔。

Micro LED 领域开始展现其作为平台型技术的巨大潜力，技术突破从超高清显示、AR 眼镜向车载显示、高速光通讯等新兴领域延伸。AR 眼镜领域，根据 CSAResearch 数据，截至 2025 年底，雷鸟、XREAL、影目、魅族等 18 个品牌推出超 30 款 Micro LED AR 眼镜，Micro LED 以亮度和功耗的先天优势成为 AR 眼镜行业创新最活跃的领域。车载领域，奥迪、奔驰、蔚来等国内外多款新车型搭载了 Micro LED 智能大灯技术，提升了照明精度和驾驶安全性。高速光通讯领域，根据 TrendForce 集邦咨询，Micro LED CPO 方案凭借能耗优势有望成为机柜内短距高速传输的替代方案，包括台积电及微软、Credo、Avicena 等企业正积极布局相关的研发与产业化，台积电宣布生产基于 MicroLED 的互连产品，微软推出采用数百个低速并行的 Micro LED 通道的 MOSAIC 光互连方案，Credo 通过收购强化光互连技术能力。随着全球科技巨头的积极布局将加速 Micro LED CPO 方案的产业化进展，Micro LED 产业将受益于高速光通讯市场需求的高速增长。

2025 年汽车制造商积极利用自适应性头灯、Mini LED 尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯/全宽带前

灯条、氛围灯、Mini LED 背光显示等高附加价值产品进行市场营销，根据 TrendForce 数据，2025 年年车灯/车用 LED 市场分别达到 357.29 亿美元与 34.51 亿美元。根据 CSA Research 数据，目前全球车用 LED 器件市场的 70%以上仍被 ams OSRAM、日亚、Lumileds 三大龙头企业占据，国产 LED 车灯产业链上中下游企业已逐步完善器件规格，加强模块化供应及灵活响应能力，国产替代将持续加速。

商业卫星发射数量近年呈现高速增长态势，根据国海证券研究所数据，截至 2025 年末，全球十大巨型星座（包括星链、Oneweb、星盾、星网、Kuiper、千帆、PWSA、Lynk、E-space、银河）累计共发射 12,575 颗星，未来总规划发射卫星数量超 8 万颗星，且会持续扩容，同时新的巨型星座也将会持续涌现，可见卫星产业具备广阔成长空间，将带动包括太阳翼在内的全产业链生态快速成长。砷化镓太阳能电池片相较硅太阳能电池，具有重量轻、转化效率高、耐高温性好、有效发电时间长等优势，已成为国内外航天器电源系统的主流技术路线之一。随着技术不断升级，迭代产品柔性砷化镓太阳能电池片既能减轻重量，又能提升光电转换效率，在商业航天快速发展的拉动下，柔性砷化镓太阳能电池片的市场应用将会大幅增长。

植物照明市场需求在粮食安全、城镇化和资源短缺、绿能产业链环保议题等背景下快速增长，在城市农业、园艺、花卉种植等领域得到广泛应用。TrendForce 预估 2025 年全球 LED 植物照明市场规模将达 13.66 亿美元，同比增长 3.9%。

面对照明市场需求疲软等严峻挑战，我国加大政策调节力度，推出了一系列助力 LED 产业转型升级的政策。2024 年 5 月国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，要求加快用能产品设备和设施更新改造，通用照明设备中的高效节能产品占比应达到 50%。2025 年 1 月，国务院办印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》的通知，支持发展夜间文旅经济，支持各地对消费集聚商业区的夜间照明和夜景灯光升级改造。2025 年 3 月，工业和信息化部、教育部、市场监管总局三部门印发《轻工业数字化转型实施方案》，提出加快绿色化转型，加快完善家电、照明等终端产品能效标准，引导企业强化产品绿色设计，增强绿色智能产品研发供给能力。2025 年 9 月，教育部等六部门印发《县域普通高中振兴行动计划》，提出改善办学条件，升级教学仪器设备，加强学科教室、实验设备、体育器械、照明灯具等教学条件配备。上述政策推动了 LED 产业向高端化、智能化、绿色化转型，拉动了工业、文旅、教育等场景的广泛需求。

2、集成电路行业

在 AI、IoT、6G、自动驾驶等新兴技术强劲需求的拉动下，全球半导体市场规模快速增长，根据 WSTS 数据，2025 年全球半导体销售额达 7,917 亿美元，同比增长 25.6%。但在下游市场需求复苏的背景下，我国仍为集成电路进口大国，根据海关总署统计，2025 年我国集成电路进口金额达 4,243 亿美元，而我国集成电路出口金额仅为 2,019 亿美元，贸易逆差仍较显著，集成电路国产化率亟待提升。

2025 年以来，多部门陆续印发了规范、引导、鼓励、规划集成电路行业的发展政策，内容涉及税收优惠、金融支持、产业生态等多维度。2025 年 3 月，国家发展改革委等部门发布关于做好

2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知，从税收角度支持集成电路相关产业高质量发展。2025 年 8 月，中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。2025 年 8 月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，主要预期目标为规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7% 左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到 5% 以上。在国家政策的大力支持下，国产集成电路厂商发展机遇凸显。

（1）电力电子

电力电子器件又称为功率器件，主要应用于变频、变压等领域。第三代半导体功率器件主要以碳化硅和氮化镓为代表，具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能。我国“十五五”规划已将碳化硅、氮化镓列入产业重点发展方向，随着国家半导体产业战略的实施，以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体行业已成为面向经济主战场的战略性行业。

①碳化硅

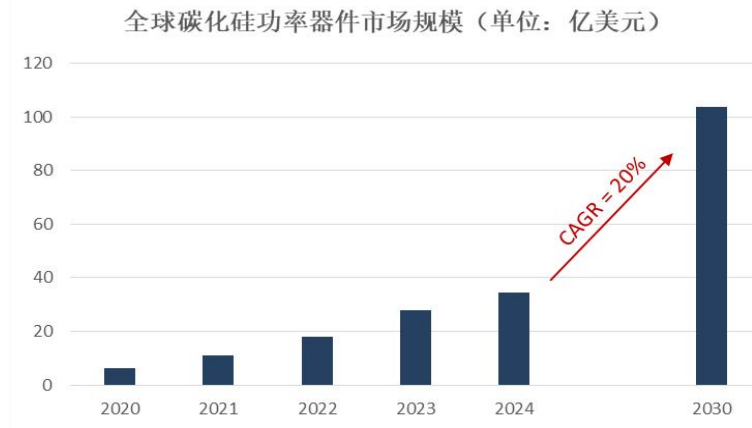
碳化硅功率器件凭借禁带宽度大、饱和电子漂移速率高、导热率高、击穿电场强度高优势，被广泛应用于新能源汽车、充电桩、光伏储能、数据中心服务器等应用领域。根据 Yole 数据，2024 年全球碳化硅功率器件市场规模为 34.30 亿美元，预计 2030 年有望达到 103.85 亿美元，2024-2030 年的年复合增长率约 20%。

新能源汽车市场：碳化硅器件被广泛应用于新能源汽车的电机控制器、车载充电机（OBC）、车载 DC-DC 变换器、电池管理系统等领域。根据行家说三代半数据，截至 2025 年三季度末，全球累计公布的 SiC 车型款式已累计达到 347 款，实现两年内翻番，反映出 SiC 技术在电动车领域已迈向规模化应用。同时，伴随产业链降本及车企对高性能配置的追求，主驱碳化硅模块已下沉至 10-15 万元价格段车型，在新能源汽车市场的下沉渗透将持续拉动全球碳化硅市场规模的增长。

光伏储能市场：碳化硅在光伏逆变器及储能变流器中能够提升系统效率、简化拓扑结构，当前逆变器厂商均在积极将碳化硅器件导入应用，且从早期的微逆逐步开始应用于组串式光伏系统，甚至兆瓦级的集中式光伏系统中。根据国家能源局数据，截至 2025 年底，我国太阳能发电装机容量达到 12.0 亿千瓦，同比增长 35.4%。未来，光伏储能产业的稳健增长及碳化硅器件应用的持续渗透将继续为碳化硅市场增长提供坚实助力。

充电桩市场：公共直流充电桩向更大功率、更高功率密度、更智能化等方向快速演进，要求电源模块的功率等级和功率密度不断提升，从 20kW/30kW 逐步提高至 40kW/50kW 及以上，这使得充电桩领域对 SiC 功率器件的需求也在快速提升。根据国家能源局数据，截至 2025 年底，我国电动汽车充电设施总数达到 2009.2 万台，建成全球最大电动汽车充电网络，可支撑超 4000 万辆新能源汽车充电需求，未来充电设施的加速建设将快速拉动碳化硅器件需求。

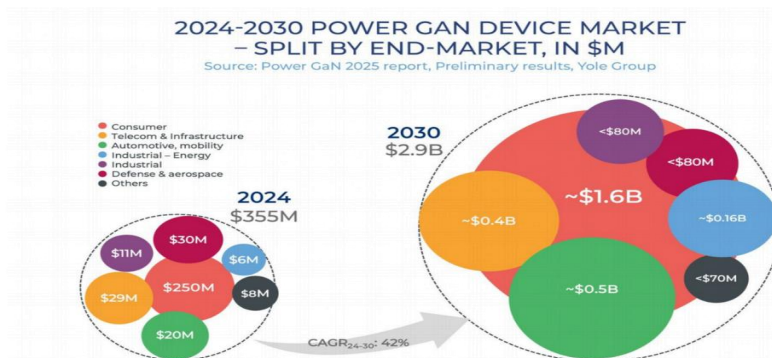
PFC 电源市场：碳化硅、氮化镓在 PFC 电源上的应用能够显著提升其电源效率，并减小体积，因此已开始逐步在 PFC 电源领域替代原有的硅基功率器件。特别是在服务器电源的 PFC 中，碳化硅器件可以提升服务器电源的功率密度和效率，缩小数据中心的体积，降低数据中心的建设成本。目前已有台达、光宝、欧陆通等众多电源模块厂商推出应用碳化硅器件的服务器电源产品，预计未来 AI 技术的不断演进和数据算力需求的持续提升，有望拉动服务器电源用碳化硅市场持续增长。



同时，碳化硅材料也在 AR 眼镜、热沉散热等新兴应用领域呈现出高成长性。在 AR 眼镜领域，碳化硅材料可以通过高折射率和高热导率两大核心特性，系统性解决 AR 眼镜的视场角窄、彩虹伪影及散热难题。伴随 AI 技术的快速发展以及智能眼镜硬件的不断升级，AI+AR 智能眼镜将进入高速发展期，根据维深信息 wellseenn XR，2025 年全球 AR 眼镜销量达 110 万台，同比实现翻倍增长，预计 2030 年全球 AI 眼镜出货量有望增长至 8,000 万副。根据行家说 Research 数据，按照一片 8 吋片可供 4 副 AR 眼镜折算，AR 眼镜市场有望为半绝缘碳化硅衬底提供广阔增量空间。在热沉散热领域，碳化硅及金刚石的热膨胀系数、热导率参数优于氮化铝陶瓷、氧化铍陶瓷等传统热沉材料，因此能更有效的将热量散出，同时避免热应力损坏芯片，在先进封装、5G 基站、激光电视、激光切割等应用场景具备广阔市场。

②氮化镓

氮化镓器件作为电力电子领域的核心技术之一，可以实现更高的系统效率、更少的功率损耗和更小的模块体积，广泛应用于低功率消费电子市场，并逐步向新能源汽车、高功率数据中心、通信电源等应用场景渗透。根据 Yole 数据，全球氮化镓功率器件市场规模将从 2024 年的 3.55 亿美元增长到 2030 年的 29 亿美元，年复合增长率预计将达 42%。



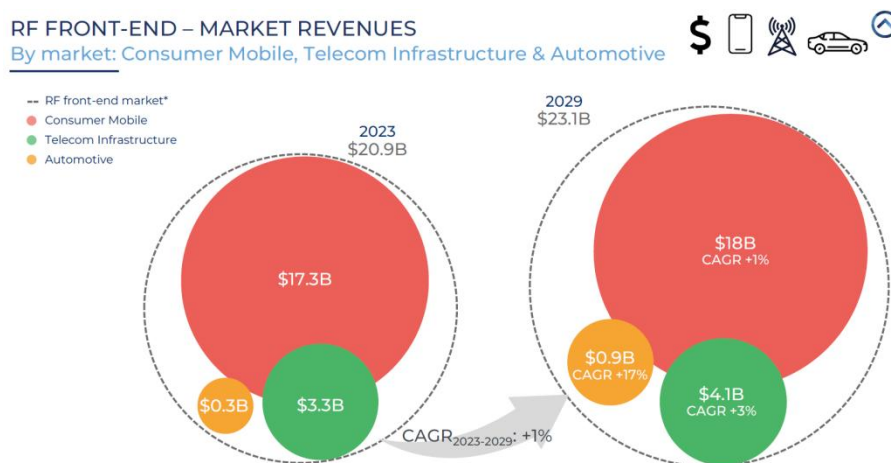
(2) 射频前端

射频前端由功率放大器、低噪声放大器、滤波器、射频开关、天线调谐器等器件组成，其作用主要为无线电磁波信号的发射和接收，将数字信号转换成射频信号，是无线通信系统的核心组件。目前无线通信市场已全面迈入 5G 时代，未来 6G、低轨卫星等移动通信技术的蓬勃发展将继续拓宽射频前端的应用场景与空间。根据 Yole 预测，全球射频前端市场规模将由 2023 年的 209 亿美元增长至 2029 年的 231 亿美元，至 2029 年，手机等移动终端、通信基站、汽车三大应用领域将分别贡献约 180 亿美元、41 亿美元、9 亿美元的市场。

手机等移动终端市场：根据 Omdia 数据，2025 年全球智能手机出货量同比增长 2%，达到 12.5 亿部，从而带动手机用射频前端需求增长，同时物联网、智能家居等领域对射频前端模组的需求也在持续增长。5G 通信技术渗透率持续提升，推动射频前端模组市场价量齐升，叠加供应链国产化替代浪潮加速，国内射频前端厂商具备广阔发展空间。

通信基站市场：根据工信部数据，截至 2025 年底，我国 5G 基站数达 483.8 万个，平均每万人拥有 5G 基站 34.4 个，高于“十四五”信息通信行业发展规划建设目标 8.4 个。未来，大规模 MIMO 和 RHH 技术的引入、6GHz 以及更高频段的开发、小型基站和专网的应用铺设等将刺激下一代通信设备的迭代，主导通信基站用射频前端器件增长。

汽车市场：5G TCU 技术和先进的射频前端模组可以为车辆提供更高的带宽、更低的时延并支持更广泛的频段，以响应智能化车辆对于数据和无线通信的需求，在电动车智能化的趋势推动下，车规级无线通信网络将贡献新的增长空间。

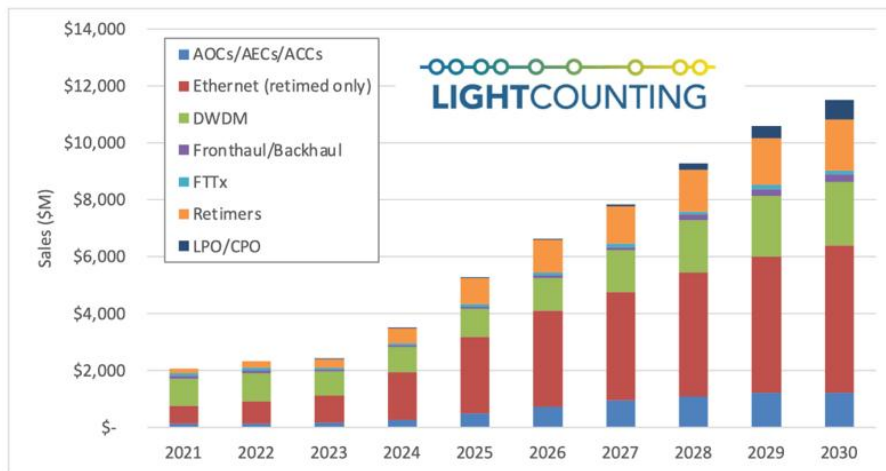


(3) 光技术

光芯片是实现光电信号转换的基础元件，按功能可以分为激光器芯片（VCSEL、FP、DFB 和 EML 等）和探测器芯片（PD 和 APD 等），在光通信领域得到重要应用。光芯片作为光模块的核心部件，性能直接决定光通信系统的传输效率，光芯片价值占比随光模块速率的提升而上升。

光纤宽带、5G、数据中心、云计算设施、智能计算中心等设施建设持续推进，全球数据流量急剧增加，大规模的数据处理需求，刺激光模块及其配套芯片持续迭代发展。在 AI、元宇宙等浪潮的推动下，网络传输速度将大幅提升，400G 以上高速率光模块需求加速释放，驱动光芯片市场

增长。根据 LightCounting 数据，全球光芯片市场规模有望从 2024 年的 35 亿美元增长至 2030 年的超 110 亿美元，年复合增长率约 17%。

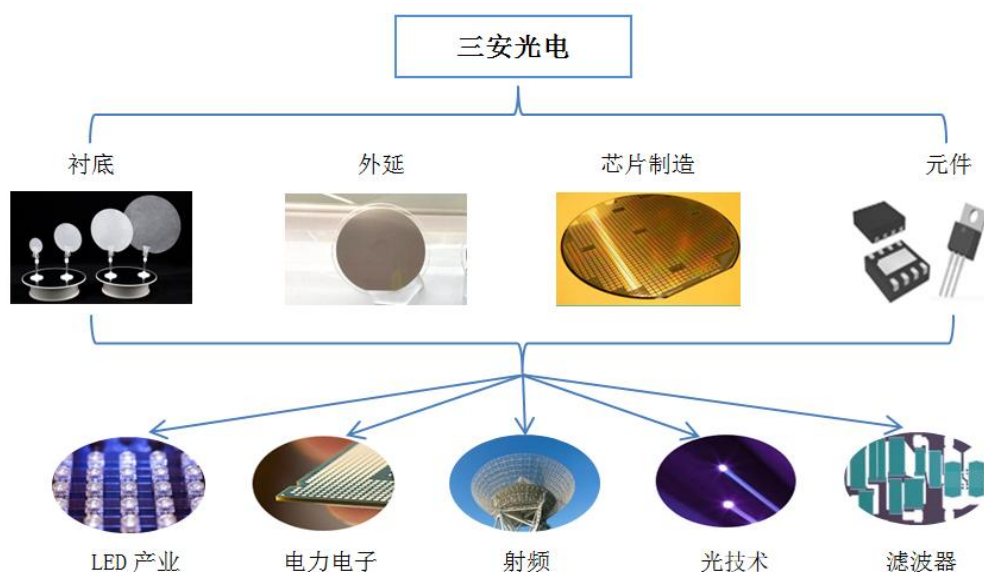


(一) 公司主要业务

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售，以蓝宝石、砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，主要产品、材料、产品系列及相关应用领域如下表：

产品范围	材料	主要产品	产品系列	主要用途/应用领域
LED外延芯片	GaAs、GaN	LED外延片	红色、黄色、橙色、黄绿色 紫色、蓝色、绿色	LED产业链的上游产品，用于生产LED芯片。
		LED芯片	红色、黄色、橙色、黄绿色 紫色、蓝色、绿色	提供给LED封装厂商用于生产LED终端产品，可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗、汽车、AI/AR眼镜等众多领域。
LED应用产品	GaAs、GaN	LED车灯	前灯、后尾灯、室内灯、标志灯、氛围灯	LED产业下游产品，提供给汽车主机厂进行整机组装。
集成电路芯片	GaAs、GaN、LT/LN	射频芯片	HBT、pHEMT、HEMT	移动终端、通信基站、无线局域网络、智能穿戴、汽车智能驾驶、机器人、卫星通信等领域。
		滤波器芯片	SAW、TC-SAW	移动终端、汽车智能驾驶、物联网、卫星通信等领域。
	SiC、GaN	电力电子芯片	碳化硅MOSFET、碳化硅二极管、碳化硅衬底/外延、硅基氮化镓	新能源汽车、充电桩、光伏储能、通信基站、数据中心及AI服务器、不间断电源、工业自动化、家用电器、AI/AR眼镜等领域。
	GaAs、InP	光通讯芯片、非光通讯芯片	CW光源、EML、DFB、FP、VCSEL、PD、APD	光通讯类：主要适用于5G网络、接入网、数据中心以及AI应用场景；非光通讯类：主要用于3D识别、汽车智能驾驶、激光美容器、工业加热等领域。

(二) 公司产业布局图



报告期内，本公司主营业务范围未发生重大变化。

（三）主要经营模式

公司自设立以来，一直坚持“技术+人才”的科技成果产业化模式，以技术创新为手段，以科技成果产业化为目标，不断开拓新业务，壮大实力。

采购模式主要采用“直接采购+寄售采购”的方式，大部分原材料由公司采购中心根据需求制定采购计划，向供应商直接下达订单，并签订采购合同；另有少量原材料由供应商存放在公司仓库，公司每月根据实际使用量，与供应商对账后结算。

生产模式是以“订单+市场预测”为基础，结合库存按计划组织生产。公司销售部门根据客户订单和市场预测信息传递给战略运营中心，战略运营中心结合公司库存情况制定生产计划，并传递给生产管理部门，生产管理部门按照生产计划组织生产。

销售模式主要采取直销方式，下游客户主要为 LED 封装企业、应用厂商及化合物半导体集成电路设计企业等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	58,255,915,315.08	59,052,883,378.53	-1.35	57,675,135,347.94
归属于上市公司股东的净资产	34,883,669,003.47	36,868,570,744.34	-5.38	38,303,349,738.35
营业收入	17,949,195,361.73	16,105,827,496.67	11.45	14,052,751,956.74
利润总额	-201,231,264.90	357,572,642.14	-156.28	474,609,825.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	12,007,701,702.50	11,497,969,844.33	4.43	10,202,739,061.54

归属于上市公司股东的净利润	-353,214,166.90	252,846,286.50	-239.70	366,559,956.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-827,529,770.45	-511,016,467.08	-61.94	-1,088,361,702.16
经营活动产生的现金流量净额	1,880,870,088.75	2,616,784,618.19	-28.12	3,977,380,864.98
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	0.68	减少1.67个百分点	0.97
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.05	-240.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.05	-240.00	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,312,037,853.27	4,675,354,665.50	4,829,890,875.72	4,131,911,967.24
归属于上市公司股东的净利润	211,913,413.46	-35,422,879.08	-87,889,522.96	-441,815,178.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,690,010.79	-175,038,917.29	-228,607,365.94	-498,573,498.01
经营活动产生的现金流量净额	596,154,946.00	348,235,811.66	715,126,105.26	221,353,225.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

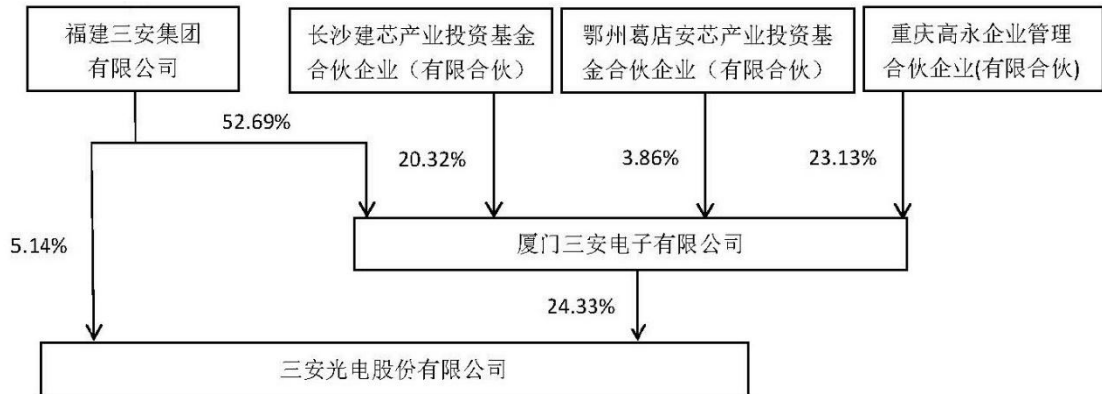
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							379,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							409,833
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门三安电子有限公司	0	1,213,823,341	24.33	0	质押	599,400,000	境内非国有法人
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)一长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	0	286,368,843	5.74	0	无	0	其他
三安光电股份有限公司回购专用证券账户	121,424,405	283,040,022	5.67	0	无	0	境内非国有法人
福建三安集团有限公司	0	256,633,542	5.14	0	质押	166,894,914	其他
三安光电股份有限公司一第五期员工持股计划	0	138,467,713	2.78	0	无	0	其他

珠海格力电器股份有限公司	0	114,547,537	2.30	0	无	0	其他
长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙)	0	96,774,193	1.94	0	无	0	其他
三安光电股份有限公司第一期员工持股计划	0	76,017,479	1.52	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,400,303	73,401,869	1.47	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	-3,000,080	66,999,920	1.34	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

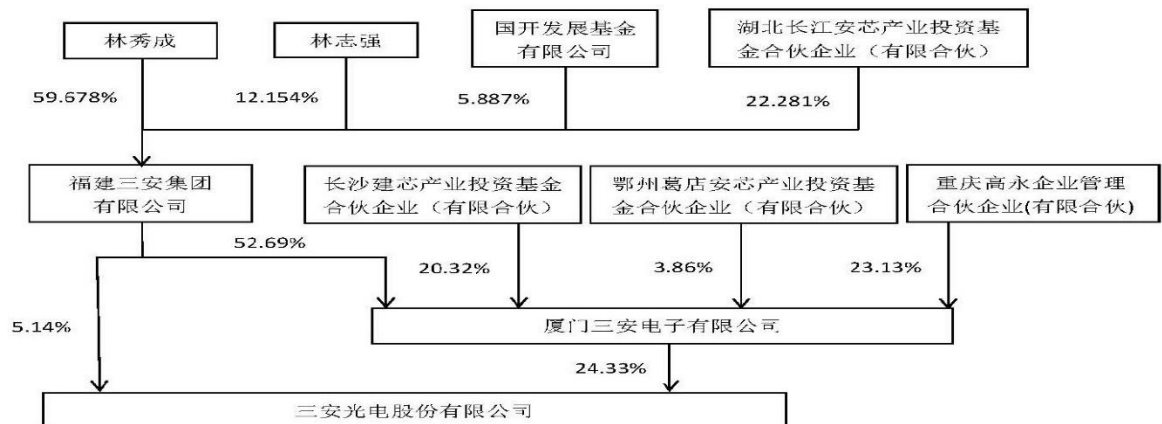
√适用 □不适用



注:该方框图为截至报告期末情况。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:该方框图为截至报告期末情况。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入 179.49 亿元，同比增长 11.45%；归属于母公司股东的净利润-3.53 亿元，同比下降 239.70%。截至报告期末，公司资产总额 582.56 亿元，同比下降 1.35%；归属于上市公司股东的净资产 348.84 亿元，同比下降 5.38%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用